

Berlin, 04. August 2015

Ausschreibung zum Aushang

Studentische Hilfskraft gesucht - Im Bereich metallische Verbindungstechnologien der Mikrosystemtechnik

In der Gruppe „Metallic Interconnection Technologies“ entwickeln wir Verbindungstechnologien (Löten, Silbersintern, Transient Liquid Phase Bonden) sowohl für die direkte Chip-Montage (Flip-Chip, die attach) als auch für die Baugruppenmontage und großflächige Verbindungen. Anwendungsgebiete umfassen dabei auch die Leistungselektronik, die HF-Technik und die Optoelektronik. Im Rahmen unseres Qualitäts- und Prüfzentrums (QPZ) für elektronische Baugruppen führen wir außerdem Qualitäts- und Zuverlässigkeitsuntersuchungen durch, inklusive Fehleranalysen an LED-Modulen.

In diesem Umfeld suchen wir Studentische Hilfskräfte, die Interesse an anwendungsnahen Forschungs- und Entwicklungsthemen haben und langfristig mit uns zusammenarbeiten wollen. Darüber hinaus bieten wir auch die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten an.

Aufgabenprofil:

Bearbeitung von wissenschaftlichen Fragestellungen aus den Bereichen Mikrosystemintegration, Montage- und Verbindungstechnik, Metallurgie, Verfahrenstechnik oder Zuverlässigkeit von Flip-Chip- oder die attach-Verbindungen. Unterstützung der Wissenschaftler und Techniker u.a. durch Anfertigung von metallografischen Schliffen, Durchführung von lichtmikroskopischen Analysen, REM-, EDX- und Röntgen-Analysen sowie Durchführung von Löt- und Sinterversuchen.

Anforderungen:

- Studierende der Werkstoffwissenschaften, Mikrosystemtechnik oder angewandte Gebiete
- Überdurchschnittliche, mindestens jedoch gute Studienleistungen
- Kenntnisse in den Bereichen Werkstoffwissenschaften, Elektrotechnik, Maschinenbau, Chemie oder Physik erwünscht
- Interesse und Engagement hinsichtlich experimenteller Arbeiten und Analytik
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office (Word, Power Point und Excel)
- Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Berichtstaugliches Deutsch und Englisch

Zeitraumen und Umfang:

Der Beginn der Tätigkeit ist jederzeit möglich. Wir bieten 41, 60 oder 80 Stunden-Verträge je Monat.

Bewerbung per Mail an:

Dr.-Ing. Matthias Hutter, matthias.hutter@izm.fraunhofer.de

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München
Vorstand

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr.-Ing. E. h. mult. Dr. h. c. Dr. h. c. Reimund Neugebauer, Präsident

Prof. (Univ. Stellenbosch) Dr. rer. pol. Alfred Gossner

Prof. Dr. rer. publ. ass. iur. Alexander Kurz

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Alexander Verl

Bankverbindung Deutsche Bank, München

Konto 752193300 BLZ 700 700 10

IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00

BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM

USt-IdNr. DE129515865

Steuernummer 143/215/20392